

SMT表面贴装技术创新演示区 (E3馆3106位)

SMT Innovation Point and Demo Line @Hall E3.3106

参展企业

Exhibitors



友情赞助

Sponsor



productronica China

慕尼黑上海电子生产设备展

2017年3月14-16日 上海新国际博览中心 E1、E2、E3馆
productronicachina.com.cn

SMT产线 / SMT Demo Line

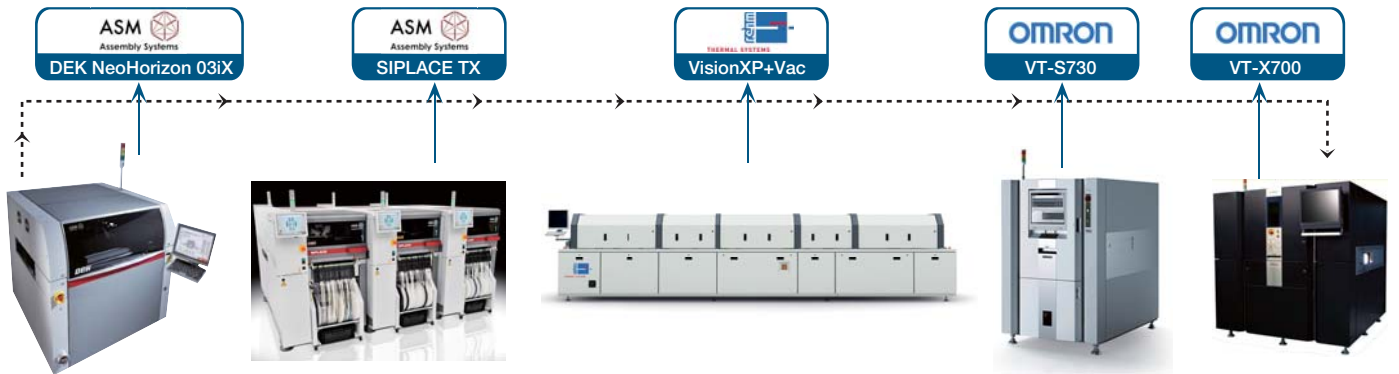
产线1: 消费电子、安防



产线2: 军工、航空航天



产线3: 智能手机、汽车电子



产线4



产品介绍 / product introduction

超高精度混合贴片机「NXT-H」



NXT-H是一款既可以对应SMT又可以对应半导体的混合型贴片机。它可以对应越来越复杂化、高密度化的生产需求。由于4~12英寸晶圆、盘装料以及带装料等物料都可以集中搭载到NXT-H上,所以NXT-H能混合贴装裸芯片与SMD元件。NXT-H能以超高精度贴装最大尺寸为610x610mm的大型电路板。另外,它还可以加工FanOut-Wafer Level Package。NXT-H可以在拼板加工或封装元件加工时发挥很大的作用。搭载H24G工作头时,NXT-H的贴装速度可以达到13,400CPH。

模组型高速多功能贴片机「NXT」



NXT 是一款真正意义上的模组化贴片机。模块化设计的器材在装卸时非常便捷。机器性能可以通过更换器材的方式得到不断提升。这款设备在全球都拥有良好的口碑,累计销售数量已经突破55,000个模组。用户可以根据产品、生产形态来组建最符合需求的机器。每种可以自由装卸的器材都可以在线外进行保养。NXT 能以±0.025mm的精度以及35,000cph的速度贴装0201元件。用“H24S与助焊剂高速浸渍装置”的组合在拼板上大量贴装WLCSP时,贴装速度可以达到18,500cph。另外,由于NXT 采用“逐一吸取”的方式吸取元件,所以可以利用IPS功能对裸芯片的吸取状态进行检测。

Ysi-V



高端混合型光学式外观检查装置
2D 高速, 高分辨率, 2D检查
3D 高度, 倾斜面, 3D检查 (选项)
4D 4方向角度相机 (选项)
双轨道传送系统 (选项)
对象基板: L50 x W50mm ~ L610 x W560 mm
最大可支持L750 mm的基板。(选配对应)
分辨率: 可视光(红/绿/蓝) & 红外线: 12μm / 7μm (可选择)
检查对象: 印刷后的锡膏检查, 贴装后的组件检查, 炉后的组件及锡膏检查

YCP10



高性能小型印刷机
特点:
实现等同于上级机型的印刷质量, 支持大型基板, 宽幅网板
承载高端机的功能, 实现高精度, 高质量的印刷
集高度通用性, 多功能于一体的小型机体
支持YAMAHA SMT生产线联机功能, 实现高效生产
基本规格:
对象基板L510 x W460mm ~ L50 x 50mm
印刷头3S(Swing Single Squeegee)刮刀头, 双刮刀头(选配)
印刷精度 重复对位精度(6): ±0.010mm
周期时间 8秒(标准印刷: 本公司最佳条件下、印刷时间除外)
可支持的网板尺寸 L750xW750mm、L736xW736mm、L750xW650、L650xW550mm、L600xW550mm(选配)、L550xW650mm(选配)、L584xW584(选配)
外形尺寸(突起部除外) L1,130mm x W1,760mm x H1,370mm

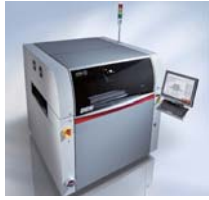
YSM20W



- 可有效大范围支持各式生产形态，拥有同级产品中世界最快速的万能型表面贴片机
 - 由1台贴装头同时实现高速性与通用性，提供理想的解决方案
 - 可贴装的元件范围广，具体实现“Limitless Expansion”
 - 多项功能作为标准配置，保证高质量的贴装。
 - 高度灵活的供料装置
- 与具备2台贴装头的2梁机型的表面贴片机在最佳条件下对比的贴装能力(CPH)。(2014年5月本公司的调查结果)

对象基板: 单轨机型 L810 x W742 ~ L50 x W50
 双轨机型 (仅限X轴为2梁规格的机型) L810 x W356 ~ L50 x W50
 贴装精度: ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≥1.0 (3)
 贴装能力: X轴为2梁规格的 : 高速通用 (HM) 贴装头x2
 80,000CPH (本公司最佳条件下) 贴装头/可贴装的元件:
 高速通用 (HM) 贴装头: 03015 ~ 45x45mm L100mm, 高度在15mm以下
 根据元件的高度、尺寸, 可能需要选配多视觉相机(可选配置)
 异型 (FM) 贴装头: 03015 ~ 55x55mm L100mm, 高度在28mm以下

DEK NeoHorizon 03ix



DEK NeoHorizon ix印刷平台凭借其高级特性, 可为您的任何产品提供功能强大且高度准确的解决方案。此外, DEK NeoHorizon Back-to-Back还进一步提升了DEK双轨印刷的概念, 这一简单巧妙的解决方案, 使其可随时间转变为两台单轨机器。您可以在保护投资的同时, 随时应对变化。DEK NeoHorizon ix的模块化结构可为您带来全面的灵活性。借助开创性的DEK HawkEye技术, 提升您的工艺制程检查。另外, DEK ProFlow ATx封闭式印刷头和DEK自动焊膏补充装置可以为您减少人为操作, 提升效率和成本。采用全新高效的DEK Cyclone Duo钢网底部清洁系统, 能够最大限度的减少您的清洁时间和耗材使用。DEK的创新技术不断挑战质量和生产效率的极限。

SIPLACE TX



SIPLACE TX: 极速的速度与品质铸就高速生产。凭借高达78,000cph的速度, 全新SIPLACE TX树立了实际贴装性能的新标杆。得益于更快的贴装速度, 和仅为100厘米宽的极为紧凑的设计, SIPLACE TX可以在仅仅4.5平方米的空间实现高达156,000cph的性能, 这标志着占地面积效率的巨大飞跃。同时, 更小、更紧凑的模块让用户能够根据需要更准确地扩展和收缩其生产线。SIPLACE TX的出色品质还确保了机器的长期准确性, 无论机器运行多久, 或者贴装多少元器件, 其性能和准确性可保证多年无恙。

Pyramax回流焊炉



PYRAMAX回流焊炉为热处理工艺设定了行业标准, 带来最高的生产能力和更高的灵活性, 为电子制造商在当今极具挑战性的市场上提供竞争优势。BTU独有的闭环对流控制技术实现了精确加热和冷却控制、连续热传递功能、最大的工艺控制灵活性和低氮消耗, 最终使拥有成本降至业内最低。PYRAMAX是业内功能最全、性价比最高的产品。

iineo



Europlacer为全球电子工业设计和制造全系列的高灵活性的SMT贴装系统。作为世界上增长速度最快的 SMT 贴装系统制造商, Europlacer将它的成长归结于两个价值理念, 即以客户为中心进行产品创新, 并在所有商业活动中保持诚信。Europlacer贴片机系列中iineo平台具有更多改进的特性, 例如庞大的供料器容量, 最大的电路板尺寸和最大的元件高度。此平台使用Europlacer特有的综合智能TM技术, 除了具有Europlacer的核心特性《高效灵活的旋转贴装头、智能供料器、3DPS、强大软件工具》, 同时也引入了新的科技《线性马达和数字化摄像机》。其他选配包括使用或不使用阿基米得螺线点的胶头, 元件电测试, 特殊吸嘴自动更换, 多程序优化软件, 生产管理软件, 全程追踪软件, 锡球供料器, 散料供料器等。

SP700系列



Speedprint是一家屡获殊荣的公司, 为SMT及半导体行业提供专注于价值、灵活性和低拥有成本的全面印刷解决方案。Speedprint产品结合了其高性能和高可靠性的承诺与所有必要的功能, 用于处理最复杂的装配。该系统的设计可应付严酷的高容量的SMT生产, 同时结合了高混合、快速的产品设置和转换的环境中所需的灵活性。SP710avi结合了Speedprint高性能和高可靠性的承诺。此系统的设计可应付严酷的高容量SMT生产, 同时在高混合的环境中应对自如。装配自动点涂器 (ADU) 的SP700avi 即是 SP710avi。配备双注射器的自动点涂器 (ADU) 允许用户把此功能结合在印刷机上, 消除额外

的资本支出。SP710avi功能独特的向下/向下视觉有利于优化电路板钢板的对准, 提供20micron, 6 sigma在2Cpk的表现。此外, 丝网印刷机无需因为基准点的质量问题而对校准妥协。

Y. Cougar



Y.Cougar - FeinFocus X射线二维和三维微焦点检测系统在开发紧凑型多功能微焦点X射线系统过程中考虑到了世界各地安装超过2500套微焦点系统的经验。Y.Cougar能满足电子业、汽车业、军事工程、飞机制造、电信和医疗技术领域最广泛的检验要求。今天, 它代表了最通用的X射线微聚焦二维和三维检测解决方案。一键点击功能使与Y.Cougar共同操作更容易。在几秒钟内可获得第一个X-射线图像。即使是无经验的运营商能够迅速得到最佳图像。就单一机组检测或检测大型单位体积而言, Y.Cougar系统是实时微焦点X射线检测的理想解决方案。这种X射线系统也可用于Ultrafast Y.QuickScan®断层摄影术。

HELLER 1913MKIII 回流焊炉



1913MKIII双轨系列
 为超高产量要求设计的产品链条速度可达140cm/min, 能配合最快的贴片机进行生产。可提供最高的稳定性, 最小的Delta T。

VisionXP+Vac 真空回流焊接系统



VisionXP+Vac 焊接系统采用了符合当下趋势的节能环保概念, 并把高品质可持续生产与现代制造业需求相结合, 在研发过程中尤其注重高能效、低排放和最低成本等因素, 是高效的节能助手。该系统配备了全新的真空模块单元, 可一步实现真空回流焊接, 直接有效地解决了焊接后(当焊料处于最佳熔解状态时)出现气孔、空洞和空隙等问题: 2mbar真空可将空洞率降到2%以下。VisionXP+Vac真空单元模块采用可分离式设计, 因此亦可用于非真空回流焊接制程, 灵活匹配您的生产需求。

高速X射线CT断层扫描自动检查装置 VT-X700



对于2D/2.5D X-ray无法检测的BGA/LGA浸润不良&高度等3D检查项目, 本装置使用CT方式获取最多300层界面图像, 再自动逻辑判定同时, 还进行分析, 精确把握不良和产线品质趋势。检查模式下可提供全数在线检查, 使CT检查方式实现4秒/FOV的检查速度。解析模式下可通过高精度还原3D实物, 详细分析工艺不良及返品品质问题。

基板外观检查装置 (3D-AOI) VT-S730



全3D-AOI高速检查机, 14年正式推出后已在全球销售近千台。对引脚起翘和开焊等难点不良有全面检查逻辑, 实现无漏失的稳定检查。高倍率相机对应01005小件轻松检出。

3D自动光学检查机



SAKI 已进入下一个的 3D AOI时代。全新款的[BF-3Di-L1]适用于大尺寸PCB。BF-3 Di系列采用多段的环形照明技术和同轴顶光投射等SAKI独有的光学设计实现全部件的3维检查。通过4向投射技术实现对J-leads, QFN封装和连接器组件的精确检测。与传统的AOI相比较, BF-3 Di系列可缩短编程时间近50%。此外, ECD功能现可与BF-3 Di 系列连接使用。

选择性波峰焊机



- 1995年, 德国埃莎发明了全球第一台选择性波峰焊
- 各焊点焊接参数可单独设定, 大大降低缺陷率
- 头动型, 三模组同步运行, 提高产能
- 大幅度降低助焊剂用量和锡渣产生, 确保低运行成本
- 独有的焊点“瘦身”功能, 控制焊点锡量
- 工艺监控摄像系统, 提供全程同步工艺可视化

回流炉



- 全球公认的顶尖品质回流焊炉
- 独有的多点喷嘴技术, 提供出色的热补偿能力
- 冷却能力强, 出板温度低
- 低能耗
- 轻盈坚固的轨道, 吸热少, 免震动

埃莎HR600全自动混合动力返修台



- 全自动完成解焊-贴装-焊接整个返修流程
- 最新浸敷技术解决返修器件印刷锡膏难题
- 领先的暗红外热风互补返修技术
- 底部加大预热区, 返修功率可达3200W

关注展会官方微信, 享受双重好礼!

一重礼

携此单页至E3馆SMT创新演示区参观, 可在接待台领取精美礼品一份, 数量有限, 先到先得

二重礼

关注展会官方微信: 慕尼黑上海电子生产设备展, 可至E2馆微信活动区(近E2馆10号门)领取精美礼品一份
 更多产品信息, 请访问productronica.china.com.cn

扫一扫



微信号: 慕尼黑上海电子生产设备展

同期论坛一览表 Forum Schedule

	3月13日, 周一 Mar 13, Mon		3月14日, 周二 Mar 14, Tue		3月15日, 周三 Mar 15, Wed		3月16日, 周四 Mar 16, Thu	
	上午 AM	下午 PM	上午 AM	下午 PM	上午 AM	下午 PM	上午 AM	下午 PM
卓美亚喜马拉雅酒店 Jumeirah Himalayas Hotel	汽车技术日 Automotive Day							
E1馆二楼M16会议室 Room M16 (2 nd floor) in Hall E1			柔性印刷电子产业论坛 Sino-Europe Flexible & Printed Electronics Forum		国际线束先进制造创新论坛 International Wire Harness Advanced Manufacturing Innovation Forum			
E2馆二楼M17会议室 Room M17 (2 nd floor) in Hall E2			电子制造技术应用大赛 Electronics Manufacturing Technology Application Contest					
E2馆二楼M19会议室 Room M19 (2 nd floor) in Hall E2			国际电动车创新发展论坛 International Forum on Innovation and Development of Electric Vehicle		中国国际汽车电子创新技术大会 China International Automotive Electronics Conference			
E2馆一楼M20会议室 Room M20 (1 st floor) in Hall E2			国际胶黏剂技术创新论坛 International Adhesive Technology Innovation Forum					
E3馆二楼M23会议室 Room M23 (2 nd floor) in Hall E3					传感器与物联网应用研讨会 Sensor and IoT Application Forum			
E3馆二楼M24会议室 Room M24 (2 nd floor) in Hall E3			电子制造自动化论坛 Electronics Manufacturing Automation Forum					
E4馆二楼M27会议室 Room M27 (2 nd floor) in Hall E4			国际电力电子创新论坛 International Power Electronics Innovation Forum					
E5馆二楼M31会议室 Room M31 (2 nd floor) in Hall E5			国际医疗电子创新论坛 International Medical Electronics Innovation Forum		国际嵌入式系统创新论坛 International Embedded System Innovation Forum			
E5馆二楼M32会议室 Room M32 (2 nd floor) in Hall E5					国际连接器创新论坛 International Connector Innovation Forum			